

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 2 部門第 1 区分  
 【発行日】平成 18 年 4 月 20 日 (2006.4.20)

【公表番号】特表 2006-507105 (P2006-507105A)  
 【公表日】平成 18 年 3 月 2 日 (2006.3.2)  
 【年通号数】公開・登録公報 2006-009  
 【出願番号】特願 2003-567551 (P2003-567551)  
 【国際特許分類】

**B 0 1 D 69/00 (2006.01)**

【F I】

B 0 1 D 69/00

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 2 月 1 日 (2006.2.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

マイクロ流体システム ( 1 0 0 ) 用の抗菌フィルタ ( 1 0 5 ) を作製するための方法であり、

基板 ( 2 1 ) を提供する工程、

基板上にフィルタ材料 ( 2 0 1 ) を形成する工程、および

マスキング技術によってフィルタ材料に複数の穴 ( 2 1 8 ) を形成する工程を含む方法であって、前記マスキング技術が、

フィルタ材料に複数のスペーサ ( 2 1 4 ) を提供する工程を含み、フィルタ材料と接触する各スペーサが、マスク材料 ( 2 1 5 ) における単一の穴に対応し、

前記マスキング技術がさらに、

スペーサの周囲にマスク材料 ( 2 1 5 ) を提供する工程、

スペーサを取り除き、それによって、マスク材料に複数の穴 ( 2 2 2 ) を形成し、かつマスク材料の穴 ( 2 2 2 ) の領域のフィルタ材料 ( 2 0 1 ) における穴 ( 2 1 8 ) を処理する工程、および

フィルタ材料の少なくともいくつかの穴を露出するために、基板の少なくとも一部を取り除く工程を含む、方法。

【請求項 2】

フィルタ材料 ( 2 0 1 ) を形成する工程が、

予め定められた基板 ( 2 1 1 ) の深さにフィルタ材料を拡散させる工程を含み、基板 ( 2 1 1 ) 内へのフィルタ材料の拡散の予め定められた深さが、フィルタ材料 ( 2 0 1 ) の予め定められた厚さに相当する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

フィルタ材料 ( 2 0 1 ) を形成する工程が、

基板 ( 2 1 1 ) 上にフィルタ膜を堆積させる工程を含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

スペーサ ( 2 1 4 ) を取り除く工程が、

スペーサ ( 2 1 4 ) を溶解することを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】

マスク材料の穴 ( 2 2 2 ) の領域のフィルタ材料 ( 2 0 1 ) における穴 ( 2 1 8 ) を処

理する工程が、マスク材料の穴（２２２）の領域のフィルタ材料（２０１）をエッチングすることを含む、請求項１に記載の方法。

【請求項６】

フィルタ材料の穴（２１８）の間でフィルタ材料（２０１）に抗菌コーティングを堆積させる工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。

【請求項７】

抗菌コーティングが銀を含む、請求項６に記載の方法。

【請求項８】

処理する工程が反応性イオンエッチングを含む、請求項１に記載の方法。

【請求項９】

スペーサがフィルタ材料に均一に分散される、請求項１に記載の方法。